

证券代码：836408

证券简称：高精数控

主办券商：银河证券

沈阳高精数控智能技术股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等相关规定及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，公司董事会对募集资金使用情况进行专项核查，出具《公司募集资金存放与使用情况的专项报告》。

一、募集资金的基本情况

2016年9月22日沈阳高精数控智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于<沈阳高精数控智能技术股份有限公司股票定向发行方案>的议案》。公司发行股票数量为1,800,000股，发行价格为人民币1.42元/股，公司共募集资金25,560,000.00元。该募集资金已于2016年11月15日全部到位，缴存银行为中信银行沈阳南湖支行（账号：8112901012600227277），并经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了瑞华验字[2016]01670021号《验资报告》审验。

公司于2016年12月13日收到《关于沈阳高精数控智能技术股

份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2016]9230号）。该账户自2016年10月31日至2016年12月13日发生的任何资金支出均未使用认购人缴存的股份认购款。

截止2018年12月31日，本公司募集资金使用情况如下：

项目	金额（人民币元）
募集资金净额	25,560,000.00
减：累计使用募集资金	25,579,473.12
其中：以前年度已使用金额	25,525,009.67
本年度使用金额	54,463.45
加：累计募集资金利息净额	41,225.00
加：累计理财产品投资收益	
尚未使用的募集资金余额	21,751.88

二、募集资金的存放管理及制度建立情况

公司为募集资金制定了《募集资金管理制度》，并且与主办券商中国银河证券及中信银行股份有限公司沈阳分行（以下简称“商业银行”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。根据监管协议的约定，公司将本次股票发行募集资金存放于资金专用账户中（账户名称：沈阳高精数控智能技术股份有限公司，开户银行：中信银行沈阳南湖支行，账号：8112901012600227277），本次募集资金用途为补充流动资金，支持公司主营业务开展，有利于保障公司经营的正常发展，实现经营目标，从而提高公司整体经营能力，提升公司的综合竞争力，为公司后续发展带来积极影响，不存在提前使用、违规使用、挪用等情况。

三、本年度募集资金的实际使用情况

公司挂牌后共募集资金人民币 25,560,000.00 元，募集资金累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等净值为 41,225.00 元。2016 年度公司未使用募集资金，2017 年度使用募集资金 25,525,009.67 元，2018 年 1-12 月使用募集资金 54,463.45 元，截止 2018 年 12 月 31 日累计使用募集资金 25,579,473.12。

募集资金使用情况对照表

项目	金额（元）
一、募集资金总额	25,560,000.00
加：利息收入扣除手续费净额	41,225.00
二、可使用募集资金金额	25,601,225.00
三、募集资金使用(补充流动资金)	25,579,473.12
其中:购买原材料	22,694,450.05
研发投入	1,136,737.89
销售费用	804,439.10
管理费用	846,625.08
电子办公设备	97,221.00
四、截至 2018 年 12 月 31 日募集资金余额	21,751.88

四、变更募投项目的资金使用情况

截止 2018 年 12 月 31 日，不存在改变或变相改变募集资金使用用途的情况，也不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

经公司自查，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》等相关规定使用募集资金，及时、

真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金使用违规行为，亦不存在募集资金被大股东或实际控制人占用的情况。

公司已严格按照中国证监会及全国中小企业股份转让系统公司的相关制度要求，制定完善募集资金管理办法，建立募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求，加强对募集资金的管理。

沈阳高精数控智能技术股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 24 日